

ガラス基板加熱・冷却装置

特殊設計品

ガラス基板の加熱・冷却における製造プロセスを確立するために最適化された装置



仕様

寸法	ホットプレート	(W) 700 × (L) 600 × (H) 40mm
	クールプレート	(W) 700 × (L) 600 × (H) 40mm
主要材料	ホットプレート	A5052 (アルミニウム)
	クールプレート	A5052 (アルミニウム)
設定可能範囲	加熱時間	0～999秒
	冷却時間	0～999秒

特長

ガラス基板の温度プロファイルを取るにより、最適な加熱または冷却条件を見だし、プロセス設計の迅速化を実現します。基板温度の昇降試験に最適な装置です。

- ガラス基板の加熱・冷却における製造プロセスを確立するために最適化された装置です。
- ホットプレート部・クールプレート部には、長年にわたり培ってきた、均熱技術を用いています。
- クリーンルームでの使用を考慮した構造です。

温度設定範囲	ホットプレート	50 ～ 300℃
	クールプレート	5 ～ 30℃
温度均一性	ホットプレート	200℃以下 ±1℃ (550×650 mm内) 200℃超 ±2℃ ()
	クールプレート	5℃～ 30℃ ±2℃ ()
質量		約500kg

熱板式リフロー半田付装置

特殊設計品

冷却ユニット付き連続リフロー炉



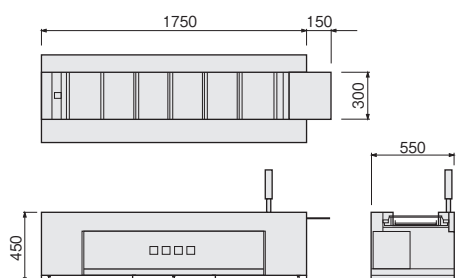
特長

治具を使用して多量の半田付けを行います。4つの均熱板と、1つの冷却ゾーンを持つリフロー半田付け装置です。

高温半田まで対応可能です

- 均熱熱板を使用していますので、品質の安定化が計れます。
- ワークの搬送は自動で、スピードコントロールが自由に設定できます。
- 小型、コンパクト設計です。
- 単独での使用の他、ライン組み込みも自由にできます。

寸法・仕様



処理部品 (ワーク)	基板 (治具保持) 最小 t5 × 幅 20 × 長さ 80
処理温度	350℃ max (熱板温度) 可変
温度精度	±3℃ (熱板表面温度)
外形寸法	幅 550 mm × 長さ 1750 mm × 高さ 450 mm (アンローダーシューター除く)

治具の大きさは、最小で幅 20 mm 厚さ t5